2018年8月1日

各　位

会 社 名　テクノプロ・ホールディングス株式会社
代表者名　代表取締役社長 兼 CEO　西 尾　保 示
（コード番号：6028　東証第一部）
問合せ先　取締役 兼 CFO　佐 藤　博
（TEL. 03-6385-7998）

連結子会社間の合併に関するお知らせ

当社の子会社である株式会社テクノプロ（以下、「テクノプロ」）は、2018 年 7 月 31 日開催の取締役会において、下記の通り、同社の子会社であるテクノライブ株式会社（以下、「テクノライブ」）を吸収合併することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 合併の目的

テクノプロ・グループ最大の事業会社であるテクノプロは機械設計・回路設計・制御開発・ソフトウェア開発の分野でビジネスを行っており、テクノライブが手掛ける事業領域やカバーする技術領域との親和性が高いことから、両子会社を合併し、経営資源の集約と業務の効率化を図ります。

2. 合併期日（効力発生日）

2018年11月1日（予定）

3. 合併の方式

テクノプロを存続会社、テクノライブを消滅会社とする吸収合併方式です。

4. 合併当事会社の概要

(1) 商号	株式会社テクノプロ（存続会社）	テクノライブ株式会社（消滅会社）
(2) 所在地	東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号	広島県広島市中区八丁堀 6 番 10 号
(3) 代表者氏名	代表取締役　西尾 保示	代表取締役　石川 洋平
(4) 事業内容	技術領域全般における技術者派遣・請負事業	技術開発支援及び受託開発サービス、システム開発
(5) 資本金	100 百万円	35 百万円
(6) 大株主及び持株比率	当社　100%	株式会社テクノプロ　100%

5. 合併後の状況

合併後の存続会社であるテクノプロの商号、所在地、代表者、事業内容、資本金の変更はありません。

6. 今後の見通し

本合併は当社の100%子会社間の合併であるため、連結業績に与える影響はありません。

以上